苹果最新旗舰机型iPhone 18 Pro系列现已开启发货，其所搭载的调制解调器芯片选择引发市场密切关注。一份最新拆解报告爆出意外特例：美版iPhone 18 Pro Max依旧采用高通骁龙X80芯片，而非苹果新发布的自研C2芯片。

据报道，调研机构TechInsights对美版iPhone 18 Pro Max进行拆解，发现该机蜂窝通信系统仍然搭载高通骁龙X80芯片。

苹果官网规格页面的信息也佐证了这一发现。美国官网页面上，仅iPhone 18 Pro明确标注搭载C2芯片，Pro Max型号并未标注调制解调器信息。

与之相对，加拿大、英国等海外市场发售的Pro以及Pro Max机型均标配苹果自研C2芯片。这一差异使得这款美国市场顶配旗舰成为全系产品中的特例，也让供应链协议再度受到审视。

行业分析师表示，苹果C2调制解调器芯片已经支持5G毫米波，能效表现优于上一代C1X芯片，上传速度更快，功耗降低15%，不存在阻碍其投入使用的技术限制。

美版iPhone 18 Pro Max成为全球唯一没有搭载C2芯片的机型，最可能的原因是履行苹果在2023年与高通签订的芯片供货协议。

随着现有合约逐步到期，苹果全面切换至自研调制解调器芯片的进程预计将持续推进。